



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008-2010年中国半导体行业研究 与发展预测分析报告

一、调研说明

《2008-2010年中国半导体行业研究与发展预测分析报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/43775.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

2003年全球半导体市场规模为1664亿美元，增长18.01%；2006年已经增长至2472亿美元，预计2007年全球半导体芯片市场的规模较上年增长2.9%，至2703亿美元。其中，英特尔2007年在全球半导体芯片市场的份额将扩大至12.2%，其营收增长是全球半导体芯片市场增长速度的两倍多，这主要得益于其笔记本电脑芯片的强劲销售。2006年，英特尔在全球市场上的份额为11.6%。预计，在未来五年内，全球半导体市场年复合增长率将保持在7.9%左右。到2010年，中国半导体市场规模将占到全球的60%。在未来几年内，全球半导体市场将保持在两位数的涨幅。2008年，该市场规模将达到3000亿美元，而2011年有望突破4000亿美元。

目前，中国已成为国际半导体芯片制造业投资最为密集的地区之一，是全球半导体芯片制造增长最为迅速的市场。2007年中国半导体芯片制造业产能较2000年增长859%，超过美国、欧洲和日本，居全球之首。继2006年实现了17.6%高速增长后，今后几年内中国半导体市场增速将放缓。2007年中国半导体销售收入将首次突破500亿美元，预计达到520亿美元，而2006年为450亿美元，增长幅度为15%。而2008年增幅将降低为12%至580亿美元。2007-2011年的增长速度将分别为15%、12%、10%、11%及13%。

本报告以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表帮助半导体制造企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家信息中心和国家统计局等权威渠道数据，同时采用中心大量产业数据库以及我中心的实地调研，且综合运用定量和定性的分析方法对行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。本报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多数据中提炼出了精当、真正有价值的情报，并结合了行业所处的环境，从理论到实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。这是我们专家小组历时一年精心制作而成，它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值，是企业制定市场策略的必备精品！

【 目录 】

第一章2007年半导体跨国公司在华经营状况分析

第一节背景情况分析

一、全球半导体市场规模

二、全球半导体产业现状

1、全球半导体资本支出情况

2、影响资本支出向中国转移的主要因素分析

三、中国半导体产业现状

第二节主要半导体跨国公司在华经营情况分析

一、经营特点

1、研发(R&D)投入明显增加

2、投资倾向于独资方式

3、基础研究将随知识产权的保护日益增加

4、跨国半导体公司投资区位选择的因素分析

5、研发机构本土化趋势加快

6、2007年跨国半导体公司资本支出情况分析

二、经营现状分析

第三节2007-2010年半导体跨国公司在华发展影响因素分析

一、驱动因素

1、高度景气的中国集成电路市场

2、政府的产业政策支持

二、制约因素

1、全球集成电路产业向中国转移的阶段性

2、半导体退税政策取消影响未来投资

3、国外政府出口限制政策也会对半导体投资产生不利影响

第二章2007年中国半导体产业发展现状分析

第一节中国半导体产业发展历程

第二节中国半导体产业概述

一、半导体产业链结构

二、半导体产品分类

三、半导体制造流程

四、半导体集成电路类别

第三节2007年中国半导体市场分析

- 一、半导体市场现状分析
- 二、半导体应用领域分析
- 三、半导体资本支出分析
- 四、半导体产能分析
- 五、半导体主要厂商排名

第三章晶圆制造产业概况

- 第一节晶圆制造工艺简介
- 第二节全球晶圆产业及主要厂商
- 第三节中国半导体产业政策环境
- 第四节中国晶圆制造业现状及预测

第四章半导体封装产业发展分析

- 第一节产业发展概况
 - 一、发展现状分析
 - 1、产业规模
 - 2、产业结构
 - 二、主要特点
- 第二节半导体封装材料整体市场状况
 - 一、引线框架市场分析
 - 1、规模与结构
 - 2、市场特点分析
 - 二、塑封料市场分析
 - 1、规模与结构
 - 2、市场特点分析
 - 三、键合金丝市场分析
 - 1、规模与结构
 - 2、市场特点分析
- 第三节半导体封装材料市场发展驱动因素分析

第五章半导体功率器件市场发展分析

第一节 半导体功率器件市场概况

一、国外市场规模与特点

二、国内市场结构分析

第二节 重点半导体功率器件产品市场概况分析

一、MOSFET

1、市场规模与增长

2、产品结构

3、应用结构

4、工艺结构

二、IGBT

1、市场规模与增长

2、产品结构

3、应用结构

4、封装结构

三、电源管理芯片

1、市场规模及增长

2、产品结构

3、应用结构

第三节 2007 - 2010年中国半导体功率器件市场预测

第六章 半导体分立器件制造行业发展状况分析

第一节 2008年行业宏观经济形势与政策环境

一、宏观经济形势分析

二、政府对产业的政策及影响分析

第二节 半导体分立器件制造行业全球发展状况及趋势

一、行业发展状况分析

二、当前行业发展特点

三、全球市场环境分析

四、主要行业企业介绍

五、行业发展趋势分析

第三节 行业存在问题及应对策略

一、行业存在问题以及发展限制

二、应对策略

第七章中国LED产业运行状况分析

第一节中国LED市场现状分析

- 一、2007年LED现状概述
- 二、中国LED研发及生产区域分析
- 三、LED重点区域与企业详析
- 四、中国发展LED照明产业的三大优势
- 五、LED应用市场现状分析

第二节中国高亮度LED市场分析

- 一、积极的产业政策带来新契机
- 二、应用领域广泛
- 三、市场规模预测

第三节2006-2007年LED产品进出口情况简析

- 一、照明产品出口分析
- 二、照明产品进口分析

第四节2007-2010年半导体照明现状及前景预测

- 一、2007年上半年行情看好
- 二、企业纷纷建设产业基地
- 三、政策扶持前景广阔
- 四、三大利好因素推动中国半导体照明市场

第八章2007年中国半导体产业市场竞争分析

第一节2007半导体产业竞争格局分析

第二节优势企业竞争战略分析

- 一、研发战略
- 二、营销战略分析
 - 1、顾客满意战略
 - 2、产品策略
 - 3、品牌策略
 - 4、销售渠道
 - 5、营销新模式

三、人力资源

1、高承诺企业组织

2、激励体系

第九章2007年全球半导体原材料市场分析

第一节半导体原材料行业概述

第二节全球半导体原材料市场分析

第三节中国半导体原材料市场分析

第四节中国半导体原材料主要厂商分析

一、峨嵋半导体材料厂

二、有研半导体材料股份有限公司

第十章2007年半导体专用设备产业发展分析

第一节2007年半导体专用设备产业发展概况

一、发展现状

二、主要特征

三、发展热点

第二节2007年半导体专用设备市场竞争格局分析

一、市场发展现状

二、细分产品-晶圆处理设备

三、细分产品-封装设备

四、细分产品-测试设备

第十一章2007年中国IC设计市场分析

第一节设计行业概述

一、设计行业特点

二、IC设计流程

三、IC设计方法演进路线

四、SOC主要特性及关键技术

五、IC设计业务模式

六、IC设计竞争力影响因素

第二节2007中国IC设计行业分市场分析

- 一、中国消费类IC设计市场分析
- 二、中国通信IC设计市场分析
- 三、中国工业控制类IC设计市场分析

第十二章2007年中国IC制造市场概述

- 第一节中国IC制造市场概述
- 第二节全球及中国主要IC制造厂商分析

第十三章2007年中国IC封测市场分析

- 第一节IC封测概述
- 第二节主要IC封装技术比较
- 第三节2007全球及中国IC封测市场现状分析
- 第四节中国主要IC封测厂商
- 第五节未来几年IC封装发展趋势

第十四章2007-2010年半导体行业投资前景及发展策略分析

- 第一节2007-2010年半导体行业投资前景分析
 - 一、个人电脑与掌上型电子产品等需求持续增长
 - 二、中高档产品领域具有较大市场空间
- 第二节2007-2010年半导体行业投资风险预警
- 第三节2007-2010年半导体行业投资策略及建议

图表目录部分

- 图表12006年各地区半导体规模增长速度对比图
- 图表22003-2011年全球半导体市场规模及预测走势图
- 图表32005-2007年第三季度我国集成电路市场销售收入增长趋势图
- 图表4世界分类PC市场
- 图表5半导体市场3大产品的发展
- 图表6各地区的DRAM生产
- 图表72005年中国市场十大半导体供应商排名
- 图表82002-2006年全球Foundry厂商销售额（按类别划分）
- 图表92002-2006年全球Foundry生产线销售额结构（按尺寸划分）

图表102002-2006年全球Foundry产能及实际产量情况

图表112006年全球TOP10Pure-playFoundry企业

图表122002-2006年中国Foundry产业销售额规模及增长

图表132002-2006年中国Foundry产能及实际产量情况

图表142002-2006年中国Foundry生产线产能结构（按尺寸划分）

图表152006年中国主要Pure-playFoundry企业

图表162007-2011年全球及中国晶圆代工市场规模预测

图表172001-2006年我国半导体封装产业规模单位：亿元

图表182005年我国半导体封装产业结构

图表192000-2005年我国塑封料需求量及同比增长率趋势图

图表202001-2006年我国键合金丝需求量及同比增长率趋势图

图表21半导体功率器件市场结构

图表222010年电源管理芯片市场规模及增长情况单位：亿元

图表23中国电源管理芯片市场品牌结构

图表24电源管理芯片消费领域比例情况

图表252002-2006年中国功率器件市场规模与增长单位：亿元

图表262007-2011年中国功率器件市场销售额单位：亿元

图表272006-2007年11月我国半导体分立器件制造行业主要经济指标

图表282006-2007年11月我国半导体分立器件制造行业竞争及亏损情况

图表292007年1-11月我国半导体分立器件制造行业不同规模企业个数分布图

图表302007年1-11月我国半导体分立器件制造行业不同所有制企业个数分布图

图表312000-2006年国内LED产量和销售额增长情况

图表322005-2006年国内LED产量和销售额

图表33四大产业区域特点

图表34四大产业区域代表企业

图表352004年国内LED应用市场分布

图表36高亮度LED市场增长情况单位：百万美元

图表37全球高亮度LED应用结构

图表38高亮度LED市场（不含手机应用）增长情况单位：百万美元

图表39各项HB-LED应用正处于产品周期的不同阶段

图表40LED应用发展趋势

图表41LED普通照明市场预测单位：百万美元

图表422003-2007年中国大陆发光二极管、光敏半导体器件出口增长
图表432003-2007年中国大陆发光二极管、光敏半导体器件进口增长
图表442003-2006年中国大陆发光二极管、光敏半导体器件进出口额增长比较
图表45江苏省制定2005-2007年半导体照明发展计划
图表46 深圳市半导体照明发展计划
图表47厦门、江西、上海、大连半导体照明计划
图表482007年LME铜价走势图
图表492006-2007年全年铜价对比图
图表502002-2006年中国多晶硅供需形势图
图表512006-2007年上半年单晶硅进出口单价走势图
图表52我国半导体硅材料生产企业（2006年销售收入过亿）
图表532001-2006年公司主要经济指标运行情况单位：万元
图表54公司近几年的总资产及主营业务收入变化趋势图
图表552001-2006年公司净利润变化情况
图表562001-2006年公司总利润变化趋势图
图表572004-2008年全球半导体设备销售额单位：亿美元
图表582006-2010年全球半导体设备市场销售增长及预测单位：亿美元
图表592006-2010年全球各类半导体设备销售增长及预测单位：亿美元
图表60IC设计流程图
图表61影响IC设计产品竞争力的因素
图表62我国IC制造行业销售规模增长趋势图单位：千元
图表632006年IC生产线数量
图表642006年我国IC生产线结构图
图表652007年1-11月我国集成电路制造行业不同规模企业个数分布图
图表662007年1-11月我国集成电路制造行业不同所有制企业个数分布图
图表67IC封装代工厂的封装总量增长趋势图单位：万颗
图表68全球10大封装公司排名
图表69全球前六大封测企业毛利率比较
图表70内地IC封装测试业统计表
图表71我国IC封装测试业销售额增长情况
图表72内地封装测试企业地域分布情况
图表732006年内地封装测试企业分布图

图表742006年我国内地IC封装测试前十家企业

图表75各封装形式占比变化趋势及预测

图表762010年我国半导体销售规模预测

图表77略。。。

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/43775.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景；

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴；

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等；

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。